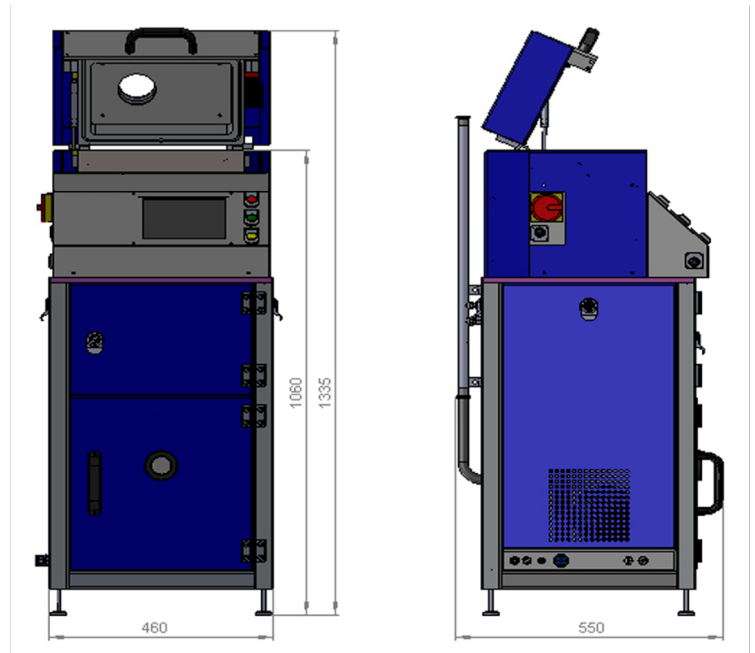


VS 160UG

Vacuum Soldering Systems

budatec[®]
Equipment for semiconductor and photovoltaic industries



| | | |
|-------------------|---------------------------|--|
| Technische Daten: | Heizplattengröße: | 160mm x 160mm |
| | max. Bauteilhöhe: | 50mm |
| | max. Löttemperatur: | 450°C |
| | Aufheiz- und Abkühlraten: | max. 3K/s |
| | max. Heizplattenladung: | 2,5kg |
| | Prozessgase: | N ₂ ; N ₂ H ₂ 95/5% |
| | Stromversorgung: | 400V /16A |
| | Kühlwasseranschluß: | 10slm |
| | Gewicht: | ~ 100kg |

- Optionen:
- HCOOH-Gaslinie mit integriertem Bubbler
 - Absolutdruckmessung
 - Drehschieberpumpe mit Zubehör (Adaptionsfalle/Auspufffilter)

Made in Germany

budatec
www.budatec.de

info@budatec.de

Stand 08/2013 Änderungen vorbehalten;

budatec GmbH, Segelfliegerdamm 92, 12487 Berlin
Tel. +49-30-63224070 Fax+49-03 -63224071